

深圳清溢光电股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“清溢光电”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，具体内容如下：

一、公司的主营业务

公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，拥有优质多样的掩膜版产品线，产品主要涉及平板显示和半导体产业，具体涵盖了平板显示、触控、柔性电路、集成电路凸块（IC Bumping）、集成电路代工（IC Foundry）、集成电路载板（IC Substrate）、MicroLED 芯片、微机电（MEMS）等领域掩膜版。

公司产品设计和制造全程可控，在 8.6 代及以下平板显示及半导体领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力。在平板显示掩膜版技术方面，公司目前已实现 8.6 代高精度 TFT 掩膜版及 6 代中高精度 AMOLED/LTPS 掩膜版的量产，实现了掩膜基板涂胶工艺的量产及半透膜掩膜版(HTM)产品的多家客户供货，正在逐步推进 6 代超高精度 AMOLED/LTPS 掩膜版的研发和高规格半透膜掩膜版(HTM)规划开发。在半导体芯片掩膜版技术方面，公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证及量产，正在开展 130nm-65nm 半导体芯片掩膜版的工艺研发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划，整体上进一步打破境外领先厂商的垄断格局，缩小与国际先进水平的差距，提高国产化进程及自主可控能力。

二、本次募集资金投向方案

（一）本次募集资金使用计划

公司本次拟向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	高精度掩膜版生产基地建设项目一期	80,001.42	60,000.00
2	高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期	60,464.56	60,000.00
合计		140,465.97	120,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

（二）募集资金投资项目基本情况及可行性分析

1、高精度掩膜版生产基地建设项目一期

（1）项目基本情况

掩膜版是图形转移的重要工具，通过将承载的电路图形以曝光的方式转移到基体材料上，基于产品用途的不同，主要应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。

本募集资金投资项目为“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”，主要产品为平板显示掩膜版系平板显示产业链上游核心材料之一。本项目计划总投资 80,001.42 万元人民币，拟投入募集资金 60,000.00 万元，主要生产 8.6 代及以下高精度掩膜版，应用于 a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、MicroLED 等平板显示掩膜版产品。项目建成投产后，将提高公司平板显示掩膜版产能，提升高精度平板显示掩膜版国产化程度及配套水平，填补国内产业空白。

（2）项目实施的必要性

1) 把握平板显示国产化发展机遇，提升公司中高精度掩膜版的制作能力并扩大产能

新型显示产业作为国家战略新兴产业，一直以来受到我国的高度重视和扶持，各级政府为相关企业提供了大量的政策倾斜和资金支持。随着中国大陆显示面板制造企业加大对显示领域的资本投入，显示面板行业呈现加速向中国大陆转移的趋势。根据 CINNO Research 统计，2016 年中国大陆显示面板产能约占全球产能的 27%，至 2021 年已达全球产能的 65%，预计 2023 年将达 74%。随着国内平板显示行业的产业迁移及技术的不断进步，国内掩膜版产品尤其是高世代、高精度掩膜版产品的需求将持续增长。

根据 Omdia 分析，2027 年全球 8.6 代及以下平板显示行业掩膜版销售收入预计达 1,293 亿日元，占全球平板显示行业掩膜版销售额的比例为 93.5%，8.6 代及以下平板显示行业用掩膜版需求保持稳定增长。中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重从 2017 年的 32% 上升到 2022 年的 57%。未来随着平板显示产业进一步向国内转移，中国大陆平板显示行业掩膜版的需求将持续上升，预计到 2026 年，中国大陆平板显示行业掩膜版需求全球占比将达到 60%。

综上，中国大陆的平板显示行业具有广阔的市场空间。掩膜版作为平板显示生产制造过程中的核心模具，国内平板显示行业的发展使得掩膜版行业的需求持续增加。本项目实施后，公司将显著提升平板显示行业高精度掩膜版的产能，为公司的可持续发展提供有力支持。

2) 打破大尺寸高精度掩膜版领域国外垄断，填补国内空白

平板显示下游应用领域决定了不同显示产品的分辨率、尺寸等主要技术指标存在差异，对掩膜版也存在高、中、低三种不同精度要求。而高精度、大尺寸掩膜版是生产 AMOLED/LTPS 及高分辨率 TFT-LCD 显示屏的关键工具，随着中国大陆 AMOLED/LTPS、高世代面板线的陆续投产，高精度、大尺寸的掩膜版需求将大幅增加。

中国掩膜版市场需求较大，但中国大陆掩膜版行业发展滞后于平板显示行业

整体投资增长，国内厂商在中高端掩膜版市场的占有率仍然较低。根据 Omdia 统计，2020 年平板显示掩膜版国产化率仅为 11%，2022 年平板显示掩膜版市场的国产化率已上升至 24%，两年内国产化率提升明显。但是在 AMOLED/LTPS 等应用领域，国产化率仍较低，2022 年 AMOLED/LTPS 等高精度掩膜版的国产化率仍只有 9%，国产替代的空间巨大。

因此，本项目的建设和实施对提高公司高精度掩膜版产能，同时提升国内高精度掩膜版的配套能力，打破进口依赖的局面，填补国内高精度掩膜版空白有着至关重要的作用，有利于促进我国电子信息产业的健康发展。

3) 推动相关产业发展，完善大湾区产业链建设

平板显示掩膜版在整个平板显示产业上下游产品中处于上游区段。未来，中国大陆平板显示行业对掩膜版产品尤其是高世代、高精度掩膜版产品的需求将持续增长。随着我国高世代、高精度面板线的陆续动工、投产，来自面板上游的关键材料（如液晶材料、CF、玻璃基板、偏光片、掩膜版等）和设备将成为制约平板显示产业发展的瓶颈。

高精度掩膜版生产基地建设项目一期的建成投产，将会带动石英玻璃材料、掩膜版用保护膜、平板显示器件生产专用设备 etc 上游产业发展，并推动下游彩色滤光片、触控面板、液晶面板产业进步，进而拉动终端应用产品如笔记本电脑、台式显示器、液晶电视等下游产业发展。此外，本项目拟在佛山实施，将会带动广佛地区配套工业的发展，有利于推进电子信息上、下游产业的紧密联系，完善广东省、大湾区乃至全国电子信息行业产业链。

综上，本项目的建设对于提升公司掩膜版产能、完善平板显示产业链、提高国内电子信息产业配套能力有着重要的意义。

(3) 项目实施的可行性

1) 国家产业政策的大力支持为项目的实施创造了有利环境

我国政府颁布了一系列政策法规，大力扶持平板显示领域的发展，平板显示行业相关的主要产业政策及规定具体情况如下：

2019年2月，国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，要求推动“新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料等发展壮大为新支柱产业，在新型显示、新一代通信技术、5G和移动互联网”等重点领域培育一批重大产业项目。

2020年9月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部发布了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，要求加快新一代信息技术产业提质增效，聚焦重点产业投资领域包括：加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。

2022年10月，国家发改委、商务部发布了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，提出将“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D显示等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外）”列入全国鼓励外商投资产业目录。

国家一系列政策的出台为平板显示及掩膜版行业的发展提供了方向和动力，故而本项目的实施符合国家产业政策导向。

2) 广阔的市场前景和丰厚的客户资源为项目实施提供了可靠保障

从产业链来看，掩膜版产业位于电子信息产业的上游，掩膜版是下游电子元器件制造商（平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业）生产制造过程中的核心模具，起到桥梁和纽带的作用，电子元器件制造商的产品则广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域，下游行业市场规模的不断增长也为掩膜版行业提供了广阔的市场空间。

掩膜版作为平板显示产业关键核心材料，其需求在显示面板大型化及高精细化发展带动下不断攀升。根据 Omdia 分析，预计 2027 年全球 8.6 代及以下平板显示行业掩膜版销售收入为 1,293 亿日元，占全球平板显示行业掩膜版销售额的比例为 93.5%，中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重从 2017 年的 32% 上升到 2022 年的 57%。未来随着平板显示产业进一步向国内转移，中国大陆平板显示行业掩膜版的需求将持续上升。公司将充分受益于电子信息产业及平板显

示行业的发展，抓住平板显示掩膜版国产替代等历史性机遇，不断取得突破。

在客户资源方面，公司的平板显示掩膜版产品和技术在业内有较高的知名度，与国内主要平板显示面板厂商均有合作，服务的典型客户包括京东方、维信诺、惠科、天马、华星光电、信利、龙腾光电、群创光电、瀚宇彩晶等客户。

综上所述，本生产基地建设项目具备良好的应用前景及丰富的客户资源，具有可靠的实施保障。

3) 公司丰富的研发储备和较强的研发实力为项目实施提供基础

公司是全球第五家、国内首家 8.6 代及以下 TFT-LCD 及 AMOLED 用掩膜版自主知识产权和生产制造厂家，具有较强的专业研发能力和产业化优势特征。公司长期专注于自主创新，已取得多项专利及技术成果，截至 2023 年 9 月 30 日，公司共拥有 56 项核心工艺技术。公司累计获授境内外专利 88 项和软件著作权 44 件，其中发明专利 30 项，实用新型专利 58 项。

公司通过不断进行研发投入和产品创新，奋力追赶国际先进技术水平，主要工艺技术已处于国内同行业领先水平。在平板显示用掩膜版技术方面，公司已实现 8.6 代高精度 TFT 掩膜版及 6 代中高精度 AMOLED/LTPS 掩膜版的量产，实现了掩膜基板涂胶工艺的量产及半透膜掩膜版（HTM）产品的多家客户供货，正在逐步推进 6 代超高精度 AMOLED/LTPS 掩膜版及相位移掩膜版（PSM）的研发和高规格半透膜掩膜版（HTM）规划开发。

综上，公司丰富的研发经验与技术储备为项目的顺利实施提供了坚实的基础。

(4) 项目投资概算和进度安排

本项目预计建设周期为 24 个月，计划总投资为 80,001.42 万元，其中拟投入募集资金 60,000.00 万元，其他费用以自筹资金投入；项目主要投入包括建安工程费和工艺设备购置费等。

本项目实施主体为子公司佛山清溢光电有限公司，项目选址定于广东省佛山市南海区。公司已与广东省佛山市南海区人民政府达成合作意向，并积极推进项目落地的相关进展，截至本说明公告日，项目用地取得、项目备案、环评手续尚

在推进办理中。

2、高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期

(1) 项目基本情况

本次募集资金投资项目为“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”，主要产品为覆盖 250nm-65nm 制程的高端半导体掩膜版。本项目计划总投资 60,464.56 万元人民币，拟投入募集资金 60,000.00 万元。本项目可提高公司半导体掩膜版产品的技术能力和产能，优化公司半导体掩膜版的产品结构，提升技术和工艺水平，提升公司在半导体掩膜版市场占有率。

(2) 项目实施的必要性

1) 紧跟半导体材料行业发展趋势，把握下游市场需求

掩膜版是集成电路制造过程中的图形转移工具或者母版，是光刻工序中不可或缺的耗材。掩膜版通过将承载的电路图形以曝光的方式转移到硅晶圆等基体材料上，成为衔接芯片设计公司 与晶圆制造厂之间的重要工具和沟通桥梁。

根据 SEMI 数据，全球半导体材料市场规模从 2017 年的 469 亿美元增长至 2022 年的 727 亿美元，年复合增长率为 9.16%，呈现稳步增长态势。与此同时，中国大陆半导体材料市场规模从 2019 年的 87 亿美元增长至 2022 年的 129 亿美元，年复合增长率为 14.24%，增速远超全球半导体材料市场增速。作为半导体材料的重要组成部分之一，掩膜版的市场规模占半导体材料市场规模的比例约为 12%，仅次于硅片和电子特气，为需求量第三大的晶圆制造材料。

随着半导体行业的不断发展，半导体掩膜版的市场需求规模预计不断提升。通过高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期的实施，公司将有望充分受益于半导体行业及掩膜版行业的发展，提升工艺和技术水平，扩充生产规模，促进公司可持续发展。

2) 加快半导体掩膜版业务布局，提高半导体产业链国产化进程及自主可控能力

半导体产业是信息经济时代的基础产业，对于我国的经济建设、国防建设、

军事安全和信息安全具有举足轻重的地位，特别是在当前国际环境下，半导体产业的国产化迫在眉睫。

在国家产业政策大力支持、国内半导体需求旺盛等因素推动下，我国半导体产业近年来取得长足发展，晶圆制造厂商制程节点和工艺水平不断突破。半导体芯片掩膜版作为晶圆制造的核心工具，由于技术壁垒高，工艺难度大，国内生产厂商的技术水平及产业化能力与美国、日本等国际先进厂商相比存在较大差距，中高端半导体掩膜版产品主要仍依赖于进口。因此，国内企业需要推动高端半导体掩膜版的生产工艺技术水平提升，加快国产化进程，实现高端半导体掩膜版的自主可控。

因此，本项目的建设和实施能够实现更高制程节点的高端半导体掩膜版的开发及产业化，进一步打破境外领先厂商垄断格局，提高国家在半导体产业链领域的国产化进程及自主可控能力，同时也能扩充公司产品类型、提升公司产品竞争力，进一步加大公司在该领域的领先优势。

3) 推动公司实现产品升级、技术领先，加强公司可持续发展能力

在当前国内晶圆制造厂商的制程节点不断进步的背景下，上游掩膜版厂商的制程节点也必须相应提升，以实现与下游晶圆制造厂商的技术匹配，进而维持公司在半导体掩膜版领域的技术领先地位。

公司产品主要包括半导体集成电路凸块（IC Bumping）掩膜版、集成电路代工（IC Foundry）掩膜版、集成电路载板（IC Substrate）掩膜版、发光二极管（LED）封装掩膜版及微机电（MEMS）掩膜版等产品。半导体芯片掩膜版技术方面，目前公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证及量产，正在开展 130nm-65nm 半导体芯片掩膜版的工艺研发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

公司通过不断地进行研发投入和产品创新，奋力追赶国际先进技术水平，通过高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期的建成投产，在现有技术能力的基础之上，提升半导体芯片掩膜版的产品精度和产能，逐步实现更高制程节点掩膜版的量产，满足客户需求的不断变化，推动公司实现产品升级、技术领先，加强公

司市场竞争能力。

(3) 项目实施的可行性

1) 国家产业政策的大力支持为项目的实施创造了有利环境

我国政府颁布了一系列政策法规，大力扶持集成电路及半导体材料领域的发展，掩膜版相关的主要产业政策及规定具体情况如下：

2020年8月，国务院办公厅出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，其中提出要进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予集成电路产业和软件诸多优惠政策。明确在规定的时期内，线宽小于0.25微米（含）的特色工艺集成电路生产企业（含掩膜版）进口用生产性原材料、消耗品等，免征进口关税。

2021年12月，工业和信息化部发布了《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，提出要加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。

2023年3月，发改委、工信部、财政部、海关总署、国家税务总局发布了《关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，其中提到2023年享受税收优惠政策的集成电路企业包括集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装基板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅片）生产企业。

国家一系列政策的出台为掩膜版行业的发展提供了方向和动力，亦是本项目顺利实施的重要政策保障。

2) 良好的市场基础及客户资源为项目实施提供了可靠保障

在半导体芯片掩膜版行业，目前公司已量产180nm工艺节点的8英寸半导体芯片用掩膜版，业务涵盖半导体集成电路凸块（IC Bumping）掩膜版、集成电路代工（IC Foundry）掩膜版、集成电路载板（IC Substrate）掩膜版、发光二极管（LED）封装掩膜版及微机电（MEMS）掩膜版等产品，产品主要应用在IGBT、

MOSFET、碳化硅和 MEMS 等半导体芯片领域。公司与国内重点的 IC Foundry、功率半导体器件、MEMS、MicroLED 芯片、先进封装等领域企业均建立了深度的合作关系，服务的典型客户包括中芯集成、三安光电、艾克尔、士兰微、泰科天润、积塔半导体、华微电子、赛微电子和长电科技等客户。

综上所述，公司良好的市场基础及客户资源为消化本募投项目新增产能形成了有力保障，是本项目实施的重要基础。

3) 公司具备深厚的研发能力，为项目实施保驾护航

较强的研发实力及人才储备为项目实施提供了有力的技术保障。公司坚持“量产一代，研发一代，规划一代”的研发方式，逐步向新技术发展，提高公司的技术能力及市场竞争力。半导体芯片掩膜版技术方面，目前公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证及量产，正在开展 130nm-65nm 半导体芯片掩膜版的工艺研发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划，主要工艺技术已处于国内同行业领先水平。公司坚持“技术创新驱动”战略，通过持续拓展半导体芯片的先进工艺研发能力和先进产品的竞争力，提升半导体芯片掩膜版的国产化率，实现关键技术的自主可控。

作为中国大陆最早进入半导体掩膜版领域的厂商之一，公司通过不断的研发投入和产品创新，技术始终保持国内领先，产品多次填补掩膜版领域国内空白，取得多项专利及技术成果。截至 2023 年 9 月 30 日，公司共拥有 56 项核心工艺技术。公司累计获授境内外专利 88 项和软件著作权 44 件，其中发明专利 30 项，实用新型专利 58 项。

自成立以来，公司高度注重科研人才梯队建设，形成一支高素质的研发团队。截至 2023 年 9 月 30 日，公司研发人员达 100 人，占公司总人数比例 17.73%，技术团队均具有专业的行业经验，研发团队稳定性强。丰富的研发经验与优秀的研发人员储备，为项目的实施提供了良好的基础。

(4) 项目投资概算和进度安排

本项目预计建设周期为 36 个月，计划总投资为 60,464.56 万元，其中拟投入募集资金 60,000.00 万元，其他费用以自筹资金投入；项目主要投入包括建安工

程费和工艺设备购置费等。

本项目实施主体为子公司广州清溢微电子有限公司，项目选址定于广东省佛山市南海区。公司已与广东省佛山市南海区人民政府达成合作意向，并积极推进项目落地的相关进展，截至本说明公告日，项目用地取得、项目备案、环评手续尚在推进办理中。

三、本次募集资金投资属于科技创新领域

(一) 本次募集资金主要投向科技创新领域

本次募集资金投资项目为高精度掩膜版生产基地建设项目一期、高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期，募集资金投向聚焦于平板显示掩膜版及半导体掩膜版相关业务，资金投向均围绕公司主营业务进行。

掩膜版是平板显示、半导体等制造过程中的图形转移工具或者母版，将承载的图形通过曝光的方式转移到基体材料上，从而实现下游产品的批量化生产，是光刻环节必要的材料，也是产业链进行衔接的桥梁。掩膜版行业承载了图形设计和工艺技术等知识产权信息，是产品精度和质量的重要决定因素之一，同时也是资金和技术双密集的产业。

掩膜版广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。在平板显示掩膜版领域，中国大陆掩膜版的发展滞后于平板显示整体投资增长，特别在 AMOLED/LTPS 等高精度掩膜版上国产化率不足，仍严重依赖进口，高精度掩膜版未来国产替代的空间巨大。在半导体掩膜版领域，我国中高端半导体掩膜版产品主要仍依赖于进口，国产化率较低，而且高端半导体掩膜版供需缺口持续扩大，低国产化率导致国内芯片公司寻找国外掩膜版厂生产掩膜版，存在核心技术泄密风险，不利于半导体产业链安全可控。因此，国内企业需要推动高端半导体掩膜版的生产工艺技术水平，加快国产化进程，实现高端半导体掩膜版的自主可控。

我国政府颁布了一系列政策法规，大力扶持集成电路及半导体材料领域的发展，掩膜版相关的主要产业政策及规定具体情况如下：2020年8月，国务院办公厅出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，其中提出要进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，在财税、投融资、研究

开发、人才、知识产权等方面给予集成电路产业和软件诸多优惠政策。明确在规定的时期内，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业（含掩模版）进口用生产性原材料、消耗品等，免征进口关税。2021 年 12 月，工业和信息化部发布了《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，提出要加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。2023 年 3 月，发改委、工信部、财政部、海关总署、国家税务总局发布了《关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，其中提到 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业包括集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装基板、抛光垫、抛光液、8 英寸及以上硅单晶、8 英寸及以上硅片）生产企业。

因此，本次募集资金主要投向符合国家战略发展方向和行业未来发展趋势，属于科技创新领域。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

高精度掩模版生产基地建设项目一期的实施对提高公司高精度掩模版产能，同时提升国内高精度掩模版的配套能力，打破进口依赖的局面，填补国内高精度掩模版空白有着至关重要的作用，有利于促进我国电子信息产业的健康发展。

高端半导体掩模版生产基地建设项目一期的实施将有望使公司充分受益于半导体行业及掩模版行业的发展，提升产品技术和工艺水平，扩充生产规模，促进公司可持续发展。与此同时，该项目能够实现更高节点的高端半导体掩模版的开发及产业化，有望打破境外领先厂商的垄断格局，提高公司及国家在半导体产业链领域的技术安全及自主可控能力。

未来，公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，紧跟掩模版行业的发展方向，结合公司的发展战略，继续加大在新技术、新产品等方面的研发投入，同时加速研发成果的市场化进程，不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力，增强公司的核心竞争力。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向方案中所列示募集资金投向均属于科技创新领域，均有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2023年12月5日